

2012-2016年电解铜箔行业市场调查及未来前景预测研究报告

报告大纲

一、报告简介

华经情报网发布的《2012-2016年电解铜箔行业市场调查及未来前景预测研究报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.huaon.com/detail/125289.html>

报告价格：电子版: 9000元 纸介版：9000元 电子和纸介版: 9200元

订购电话: 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱: kf@huaon.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

我国电解铜箔的生产起源于20世纪60年代，1963年我国建成了国内第一个电解铜箔车间——本溪合金厂铜箔车间，1965年和1967年，又先后建成了上海冶炼厂和西北铜加工厂铜箔车间。它们依靠自己开发的工艺技术，开创了我国最初的PCB用电解铜箔产业。在70年代初西北铜加工厂首先研究成功了生箔连续生产工艺，并迅速在全国推广。80年代初西北铜加工厂又率先开发了生箔阴极表面处理技术。90年代期间，随着我国电解铜箔的需求量的迅速增大，我国又有十家左右的铜箔厂家相继建立。尽管我国电解铜箔生产产量在90年代末21世纪初有了相当大的提高，但是在制造技术与产品水平上，和日本、美国相比，还存在着很大的差距。日本在全球不但生产产量居第一位，而且拥有着领先世界的电解铜箔制造技术。中国台湾在近几年产量的突飞猛进，很大程度在于大陆的应用市场的迅速扩大，并且在技术上正在迅速地攀升。与当今世界先进的电解铜箔生产企业相比，我国电解铜箔生产弊端特别明显。我国电解铜箔行业历经40多年的发展，能够具有大批量生产规模的企业均是外资企业，国内企业虽然也可以生产18p.m铜箔，甚至于12gm铜箔，但是无论从产品的品种、档次、技术、规模等方面看，与世界水平相比，仍然是很脆弱的行业。

电解铜箔是覆铜板(CCL)及印制电路板(PCB)制造的重要的材料。在当今电子信息产业高速发展中，电解铜箔被称为：电子产品信号与电力传输、沟通的“神经网络”。2002年起，我国印制电路板的生产值已经越入世界第3位，作为PCB的基板材料——覆铜板也成为世界上第3大生产国。以生产区域分析，台湾的电解铜箔产业的产值历年排名均为第一名，在全球逐渐走出金融风暴的阴霾之后，带动了电子产品市场的销售热度，也使得电子产品所需的电解铜箔的需求增加，拉升了2010年台湾电解铜箔的产值，上升18.2%，达到8.51亿美元规模，市场占有率为36.7%；第二名日本亦上升了18.9%，产值达到4.66亿美元规模，市场占有率为20.1%；全球电子产品的生产基地：中国大陆排名第三，上升了20.9%，产值提升至4.62亿美元规模，为19.9%的市场占有率。

艾凯咨询集团发布的《2012-2016年电解铜箔行业市场调查及未来前景预测研究报告》共十三章。首先介绍了中国电解铜箔行业的概念，接着分析了中国电解铜箔行业发展环境，然后对中国电解铜箔行业市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国电解铜箔行业面临的机遇及发展前景。您若想对中国电解铜箔行业有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录

第一章 中国电解铜箔行业发展概述

第一节 电解铜箔行业发展情况

一、全球电解铜箔行业发展情况

二、我国电解铜箔行业发展情况

第二节 最近3-5年中国电解铜箔行业经济指标分析

一、赢利性

二、成长速度

三、行业周期

四、当前行业发展所属周期阶段的判断

第三节 关联产业发展分析

第二章 中国电解铜箔行业的国际比较分析

第一节 中国电解铜箔行业指标分析

第二节 中国电解铜箔行业经济指标国际比较分析

第三节 全球电解铜箔行业市场需求分析

一、市场规模现状

二、需求结构分析

三、重点需求客户

四、市场前景展望

第四节 全球电解铜箔行业市场供给分析

一、生产规模现状

二、重点厂商分布

第三章 应用领域及行业供需分析

第一节 需求分析

一、电解铜箔行业需求市场

二、电解铜箔行业客户结构

三、电解铜箔行业需求的地区差异

第二节 供给分析

第三节 供求平衡分析及未来发展趋势

第四章 电解铜箔产业链的分析

第一节 行业集中度

一、行业集中度分析

二、电解铜箔行业集中度解析

第二节 主要环节的增值空间

第三节 行业进入壁垒和驱动因素

第四节 上下游行业影响及趋势分析

一、铜金属产业

二、电子信息产业

第五章 区域市场情况深度研究

第一节 长三角区域市场情况分析

一、长三角经济背景

二、长三角区域电解铜箔市场

第二节 珠三角区域市场情况分析

一、珠三角经济背景

二、珠三角电解铜箔市场分析

第三节 电解铜箔行业主要市场大区竞争力研究

第六章 2012-2016年需求预测分析

第一节 电解铜箔行业领域2012-2016年需求量预测

第二节 2012-2016年电解铜箔行业领域需求产品（服务）功能预测

第三节 2012-2016年电解铜箔行业领域需求产品（服务）市场格局预测

第三部分 电解铜箔产业竞争格局分析

第七章 电解铜箔市场竞争格局分析

第一节 行业竞争结构分析

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节 行业国际竞争力比较

一、生产要素

二、需求条件

三、支援与相关产业

四、政府的作用

第三节 电解铜箔行业竞争力分析

第四节 电解铜箔行业竞争格局分析

第八章 主要生产企业的排名与产业结构分析

第一节 行业企业排名分析

第二节 产业结构分析

第三节 产业结构发展预测

一、产业结构调整的方向政府产业指导政策分析（投资政策、外资政策、限制性政策）

二、产业结构调整中消费者需求的引导因素

三、中国电解铜箔行业参与国际竞争的战略市场定位

第九章 前十大领先企业分析

第一节 台湾长春集团

第二节 深圳市京利华贸易发展有限公司

第三节 珠海紫翔电子科技有限公司

第四节 浙江天驰电子有限公司

第五节 远东电子电路集团有限公司

第六节 信利国际有限公司

第十章 2011-2012年中国电解铜箔行业整体运行指标分析

第一节 中国电解铜箔行业总体规模分析

一、企业数量分析

二、行业生产规模分析

第二节 中国电解铜箔行业财务指标总体分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第十一章 影响企业生产与经营的关键趋势

第一节 市场整合成长趋势

第二节 需求变化趋势及新的商业机遇预测

第三节 企业区域市场拓展的趋势

第四节 科研开发趋势及替代技术进展

第五节 中国电解铜箔行业SWOT分析

第十二章 2012-2016年电解铜箔行业投资价值评估分析

第一节 产业发展的有利因素与不利因素分析

第二节 产业发展的空白点分析

第三节 投资回报率比较高的投资方向

第四节 新进入者应注意的障碍因素

第十三章 电解铜箔市场运行环境分析

第一节 2012年世界经济形势与展望

第二节 世界经济发展影响分析

一、上一轮超强刺激归于失败，负面效应全面显现

二、与2008年相比，当前世界经济是一个更凶险、更无助的困局

三、2012年外部经济环境可能变得更差，并且焦点叠出

四、中国经济将迎来“应有之痛”，并呈现出系统性拐点

五、影响分析

第三节 我国经济发展影响分析

第四节 上游产业政策分析

一、有色金属工业“十二五”发展规划

二、有色金属中长期规划

通过《2012-2016年电解铜箔行业市场调查及未来前景预测研究报告》，生产企业及投资机构将充分了解产品市场、原材料供应、销售方式、市场供需、有效客户、潜在客户等详实信息，为研究竞争对手的市场定位，产品特征、产品定价、营销模式、销售网络和企业发展提供了科学决策依据。

详细请访问：<https://www.huaon.com/detail/125289.html>